

## RTSブース・ポスター出展予定企業一覧

### デザイン&ファブレスゾーン

Design and Fab less Zone

(LSI Design, System Design, Fabless, Design Tool, Simulation Tool)

#### Seireslabs Sdn Bhd (Malaysia)

LSI 設計ファブレスメーカー：通信系デバイス

イーエヌジー(株) (Japan)

LSI 設計ファブレスメーカー：CMOS センサーコア IP

凸版印刷(株)エレクトロニクス事業本部 (Japan)

LSI 設計ファブレスメーカー：ターンキーサービス

(株)日立超 LSI システムズ (Japan)

LSI 設計メーカー・システム設計メーカー：実装ソリューション

### シミュレーションゾーン

Simulation Zone

(Design Tool, Simulation Tool)

(株)エー・イー・ティー・ジャパン (Japan)

シミュレーションツールベンダー：電磁界解析ツール

エー・ティー・イー・サービス(株) (Japan)

シミュレーションツールベンダー：DFT テスター、テスターIF ボード、Software Tool

ケイレックス・テクノロジー(株) (Japan)

EDA ツールベンダー：実装ソリューション

サイバネットシステムズ(株) (Japan)

シミュレーションツールベンダー：ANSYS

ナガセ電子機器サービス(株) (Japan) :

シミュレーションツールベンダー：3D CAD system for DFM

フルーエント・アジアパシフィック(株) (Japan)

シミュレーションツールベンダー：epak, Icechip, Icemax

モールドフロージャパン(株) (Japan)

シミュレーションツールベンダー：流動解析ツール、Moldflow MPI / Reactive Molding

### IDM・ファンダリゾーン

IDM / Foundry Zone

(Wafer Process)

EPISIL Technologies Inc. 漢磊科技股份有限公司 (Taiwan)

ファウンダリ：アナログ系デバイス、パワー系デバイス

**SAMSUNG Japan 日本サムスン(株) (Japan)**

IDM：メモリ系デバイス

(株)東芝セミコンダクター社 **(Japan, Plan)**

IDM：Cell、アナログ系デバイス、車載向けデバイス

## サブコンゾーン

Subcon Zone

(Packaging Process, JISSO, Module)

カシオ計算機(株) **(Japan)**

サブコン：ウエハレベルパッケージソリューション

(株)サンテック **(Japan)**

サブコン：パッケージング受託ソリューション

東芝 **LSI** パッケージソリューション(株) **(Japan)**

サブコン：パッケージングソリューション

阪和電子工業(株) **(Japan)**

実装メーカー：静電破壊委託試験及び高密度基板実装/鉛フリー基板実装

福菱セミコンエンジニアリング(株) **(Japan)**

評価解析メーカー：SiP 向け最先端分析技術

(株)ルネサス九州セミコンダクタ **(Japan)**

サブコン：半導体組立・テストの受託生産ソリューション

## テストングゾーン

Testing Zone

(Wafer Test, Final Test, Test Engineering, Equipment and Material for Testing)

**King Yuan Electronics Co., Ltd. KYEC 京元電子股份有限公司 (Taiwan)**

テストハウス：テストソリューション

(株)アルデート **(Japan)**

テストソリューションメーカー：テストソリューション、テストプログラム高速自動生成システム **TP-Maker**

(株)アポロウエーブ **(Japan)**

プローブカードメーカー：プロービングソリューション、高周波デバイス向けプローブカード

エスティケイテクノロジー(株) **(Japan)**

テストハウス・検査装置メーカー：KGD キャリア挿抜機・バーンインボード、テストハウス・テストエンジニアリングサービス

(株)エリア **(Japan)**

テストエンジニアリングメーカー：プロダクトエンジニアリングソリューション

ジェネシス・テクノロジー(株) (Japan)

テストハウス：総合ソリューションプロバイダ、テスト開発自動化ツール、次世代プロ  
ーブカード、導電性硬質薄膜

日本テクトロニクス(株) (Japan)

装置メーカー

横河電機(株) (Japan)

テスターメーカー

## PoP ゾーン (Package on Package)

Amkor Technology Inc. (Korea)

パッケージメーカー：ロジック系デバイス PoP パッケージ  
シャープ(株) (Japan)

IDM：メモリ系デバイス PoP パッケージ

千住金属工業(株) (Japan)

はんだメーカー：PoP 向け鉛フリーはんだ

パナソニック・ファクトリー・ソリューションズ(株) (Japan)

実装装置メーカー：PoP 実装装置

## 機器・装置ゾーン Equipment Zone (Equipment)

Integrated Reliability Test Systems Inc. IRTS (U.S.A)

検査装置メーカー：Highly Accelerated Thermal Shock (HATS) Test System

Manufacturing Integration Technology Ltd. MIT (Singapore)

製造装置メーカー：レーザーメーカー、外観検査装置

株ニコンインステック (Japan)

計測機器メーカー：広視野一括 3D 測定向け高速・高精度画像測定機

浜松ホトニクス(株) (Japan)

計測機器メーカー：光照射式静電気除去装置、フォトイオナイザ

マルコム(株) (Japan)

計測機器メーカー：テスト解析装置、SMT 品質管理装置、はんだづけ周辺装置

## サブストレートゾーン Substrate Zone (Substrate)

イビテック(株) (Japan)

プリント基板開発ファブレスメーカー：特急試作ソリューション (**Integration, Consulting, DFM**)、ベアチップ基板、信頼性・機能評価

沖プリントエドサーキット(株) (**Japan**)

プリント基板メーカー：プリント配線板

株羽野製作所 (**Japan**)

プリント基板メーカー：マルチレイヤーPCB (1~22層)、マザーボード、プローブカード、BGA向け実装ソリューション

平井精密工業(株) (**Japan**)

精密加工メーカー：LTCC サブストレート、ビアフォーミング、エッチング

日本黒鉛 (**Japan**)

黒鉛関連製品メーカー：FPC、ヒートシールコネクタ、ベースフィルム

日本サーキット工業(株) (**Japan**)

プリント基板メーカー：パッケージサブストレート

日本ミクロン(株) (**Japan**)

プリント基板メーカー：MCM (Multi Chip Module)基板、高周波モジュール基板、BGA基板、CSP 基板

## ディストリビューター&インフォメーションゾーン

Distributor and Information Zone

(Agent, Distributor, Consultant, Government):

**Malaysian Industrial Development Authority MIDA** マレーシア工業開発庁 (**Malaysia**)

行政機関：マレーシア電子産業の PR、投資誘致、マッチングサポート、工業団地紹介  
北京半導体協会日中微電子産業育成センター (**China**)

業界団体：北京半導体産業の PR、技術交流サポート、マッチングサポート

井上喜(株) (**Japan**)

商社：Highly Accelerated Thermal Shock (HATS) Test System

丸文(株) (**Japan**)

商社：超音波ウェルディング・ダイシング・ソルダリング 3次元 X線解析装置

ミナミ(株) (**Japan**)

商社：300mm ウェハ対応マイクロボール形成スクリーン印刷機

原田産業(株) (**Japan**)

商社：イオナイザー、静電気放電センサー、パッケージ開封装置